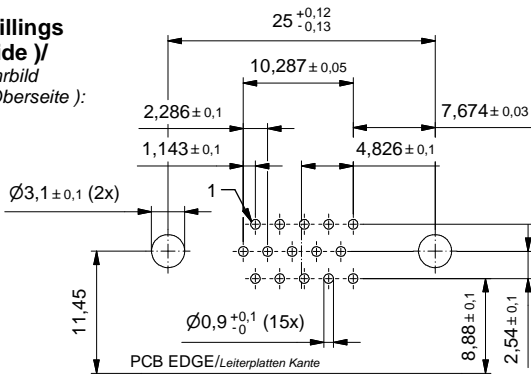


**PCB Hole drillings
(PCB Top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite):**



(b) Technical specification:

Technische Daten:

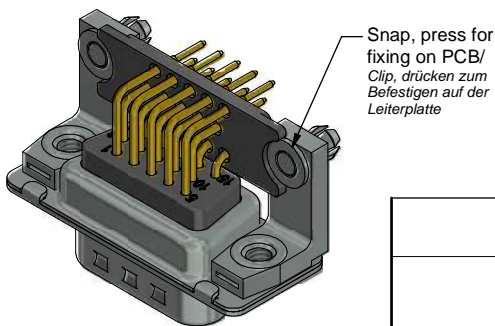
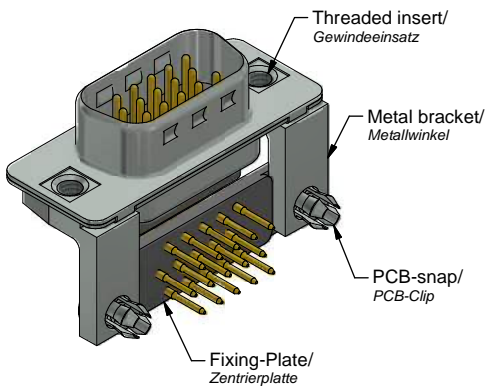
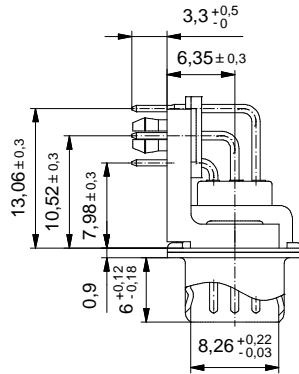
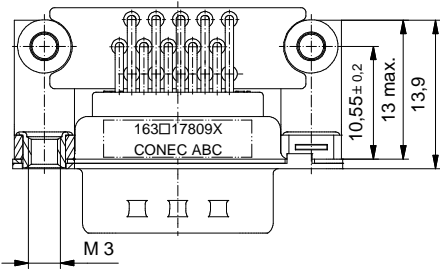
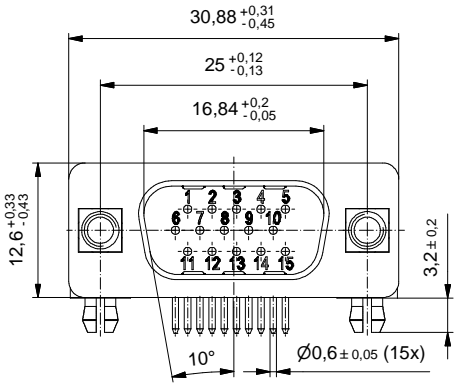
Working voltage/ Betriebsspannung:	60 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥5 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	-55 °C ... +125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	3,0 A (UL, VDE) / 2,5 A (CSA)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

**Materials/
Werkstoffe:**

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0
Fixing-Plate/ Zentrierplatte:	PBT GF UL 94 V-0
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
PCB-Snap/ PCB-Clip:	Cu alloy, Sn over Ni

**Installation specification/
Montagedaten:**

Maximum torque Value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	6 in.LB/ 67 Ncm
PCB-Snap for hole diameter/ PCB-Clip für Lochdurchmesser:	Ø3,1 mm
Circuit board thickness/ Leiterplattenstärke:	1,6 mm



(b)

Part no. / part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
163A17809X	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel
163B17809X	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
163C17809X	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel

Index: b Ä6986 30.11.017 K.H. Status: InBearbeitung RoHS compliant/konform	Scale/Maßstab: 2:1		dim. in mm Date/Datum: 30.11.2017 Name: Henneboel appd./gepr.: 04.12.2017 Schmidt	D-SUB HD Male 90° 15pos. Solder pin angled 0.350 inch threaded insert, metal bracket, fixing plate, snap D-SUB HD Stift 90° 15pos. Lötstift abgewinkelt 7.98 mm Gewindeeinsatz, Metallwinkel, Zentrierplatte, Clip	dwg no / Z.-nr.: 16K1A3998 (b)	DIN-A3 1 / 1

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to third parties without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Wir bitten Sie um die Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments sowie die Weitergabe der Inhalte an Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung zu unterlassen. Zuwiderhandlungen werden mit Schadenersatz geahndet.